

贵州振华风光半导体股份有限公司

2026 年“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，秉承中国电子“打造国家网信事业战略科技力量”、中国振华“打造电子元器件产业生态链”的定位，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量，增强投资者回报、提升投资者获得感。

现将 2026 年度上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主业攻坚，全域布局协同发展

（一）持续提升科技创新能力，构筑技术护城河

报告期内，公司建立“科研+市场”一体化研发模式：以市场需求为导向、以技术科研为支撑、以产业落地为目标，打通前端市场调研、中端技术研发、后端成果转化全链条，破除科研端与市场端信息壁垒等问题，构建“市场提需求、科研攻难关、成果转产品、市场验迭代”闭环联动的协同研发机制。其中，公司磁编码器、电机驱动、信号调理器等部分新产品与行业头部企业深度绑定，以行业头部用户实际应用需求为牵引开展定向研发，依托头部客户场景完成产品前置定义、技术指标锚定与工况实测验证，已形成显著先发优势，持续拉开与竞品在产品适配、技术成熟度等方面上的差距。

研发上，公司建立了标准化 IP 资源库，实现成熟功能 IP、工艺 IP、测试 IP 模块化复用，新品科研以成熟 IP 集成为基础，减少底层重复设计与验证工作量，压缩设计仿真周期，实现系列化产品快速迭代，建立“敏捷”研发机制，整体研发效率得到有效提升。

（二）加强核心技术攻关，夯实芯片技术根基

报告期内，公司组建了专项技术攻关组，联合高校院所开展核心技术深度研究，成功申报国家级科研项目 6 项，在集成电路设计领域公司共申请了相关发明专利 33 项，发表学术论文 9 篇。

在产品研发方面，突破了微功耗、失调电压零漂移、动态摆率提升、三维器件级的霍尔感应矩阵、TMR 磁阻、高共模抑制双向电流检测等多项核心技术；在封装方面，攻克了溢胶控制、微型化、高密度、大尺寸封装痛点等多项工艺技术；在产品测试方面，突破了存储器系统验证、机电一体化测试系统、高端 MCU 测试等多项关键技术，实现了从无到有的跨越发展。通过开展新产品的自主研制和关键技术攻关，新增 IC 设计、封装、测试等多项关键技术，持续巩固并提升产品竞争优势。

（三）工艺制造升级，测试验证完善

报告期内，公司聚焦高可靠塑封与高端倒装两大技术方向，系统开展工艺攻关并取得显著突破：在高可靠塑封工艺方面，攻克溢胶控制难题，溢胶最小宽度由 250 μm 优化至 100 μm ，显著提升了封装良率与可靠性；质量可靠性同步取得阶段性突破，实现 3 种封装形式通过 MSL1+N1 等级质量鉴定、1 种封装形式通过 MSL3+N1 等级质量鉴定，大幅拓宽了产品在高湿、高应力环境下的应用边界。

在高端工艺研究方面，针对微型化、高密度、大尺寸封装痛点攻坚，完成多款倒装样品交付及测试验证，实现 Bump Size $\leq 70\mu\text{m}$ 、Bump Pitch $\leq 130\mu\text{m}$ 、Bump 数量 ≥ 5000 的指标突破。有效夯实了封装品质基础，丰富了高端封装工艺技术储备，为公司提质降本、高端产品落地量产提供了有力技术支撑。

在检测能力上实现了从点到面、从人工到智能、从依赖外部到自主研发的跨越式提升：测试效率方面，捷变收发器测试从 30 分钟大幅压缩至 4 分钟（提升 87%）；测试规模方面，温漂筛选从少量工位突破至 100 工位并行，数据采集能力突破 500 路大规模并发；服务能力方面，从单一的客户电路验证升级为主动给多家客户设计应用电路改进方案，实现了从“能做检测”到“做精检测、做深服务”的能力跃迁。

（四）深化产学研协作，多维协同生态

报告期内，公司持续深化与高校院所及下游头部系统厂商的产学研合作，推动

“芯片定义系统”与“系统牵引芯片”双向融合，全面提升公司在高端模拟芯片领域的核心竞争力与产业链话语权。公司与国内复旦大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、西安交通大学等顶尖高校，与成都、青岛、上海、海南、重庆、石家庄、哈尔滨等地的多家半导体顶尖企业和科研院所聚焦行业前沿核心技术突破，弥补关键技术短板，开展电力工业、商业航天等民用领域的技术研究、协同创新等合作，实现优势互补、资源共享的集成电路产业生态链，构建“产学研用”深度融合的协同生态，共同推动集成电路产业的繁荣发展。

（五）拓维市场布局，构建全域发展体系

2026 年半年度，公司成功挖掘 50 余项市场需求，累计完成科技成果转化新增 75 款新品，市场推广新增 210 余款产品试用及供货。其中，合作开发的 128 通道高速数据采集 SIP 项目，定位“十五五”期间计算机平台化解决方案，用于下一代各系列通用计算机数据采集；定制研发的电感编码器芯片及其模组，分辨率达到 23 位，转速 50-70 万转/min，技术指标处于领先水平，此电机驱动芯片有望应用于“十五五”规划新一代的伺服控制系统；自研的抗辐照芯片 FX28XX 系列，已完成搭载验证，后续将持续推广；自研恒流源 SIP FHWD(Z) 产品，已成功配套某火星探测器。

2026 年半年度，公司加强攻坚民用和国际化市场，民用市场方面，开展低空经济、轨道交通、汽车电子等市场拓展及产品推广。其中商业航天领域，已成功供货恒流源、抗辐照放大器、HPLC 线路驱动放大器等产品，实现部分订货；低空经济领域，以无人机应用为主，已成功供货多款放大器产品，实现部分订货；新能源汽车领域，已成功供货 4 款产品，实现部分订货；轨道交通领域，已成功供货磁编码器、放大器等产品，实现部分订货。

国际化市场方面，公司开展产品适销改造、中英文产品手册编制等工作，并积极参与相关展会及技术交流，成功开发专用数字信号处理系统，已通过整机验证，产生批量订货。

二、深化改革创新驱动，全面激发内生发展动力

（一）抓实生产管理，提增运营效能

2026 年上半年，公司细化生产排产管理，把订单交期分解至各工序，实行日进

度跟踪、生产异常快速处置，压缩流程耗时，订单交付效率提升；优化供应链协同，推动核心供应商前置备货，降低物料断供风险，产销采衔接更顺畅，订单按期交付与客户满意度稳步改善。

（二）深化改革创新，激发内生动力

2026 年半年度，公司全面推进劳动、人事、分配三项制度改革落地实施，修订《劳动关系管理办法》等 4 项制度，出台《内部专家库管理办法（试行）》，依托人力资源咨询服务项目，构建以价值贡献为核心的绩效评价体系。本年度完成中层岗位动态调整 7 人次，关键岗位动态调整 4 人次，管理人员“能上能下”形成常态化。在绩效结果应用上，对 1 名员工实行待岗培训处理，同时兑现绩优人员薪酬增长，初步实现收入“能增能减”，市场化经营机制进一步走深走实。

公司持续推进财务精准管理，深化全面预算刚性管控，围绕战略优化资源配置。已编制成本费用压降实施方案和“三项资产”管控专项工作方案，将压降目标分解落实至各业务部门，纳入部门年度重点工作任务，各项管控措施明确责任主体。有序推进标准成本体系搭建，常态化跟踪应收账款、存货周转效率，按期组织工作进展汇报。后续将持续紧盯预算执行与成本管控落地，推动资产运营效能稳步提升

持续实施人才强企战略，聚焦芯片设计、模拟集成电路等核心领域，报告期内，引进高层次人才 3 人；持续深化校企合作，与多所双一流高校建立常态化招聘渠道，年内招录优秀应届毕业生 34 人。2026 年上半年，与西北工业大学等学校，搭建校企联合培养平台，并借人力资源咨询服务项目优化职级晋升体系，累计兑现各类人才专项补贴 29 万元。通过“引、育、用、留”全链条协同发力，人才成长通道进一步畅通，核心领域人才储备持续增强。

三、持续完善公司治理，护航稳健发展

（一）强化规范运作

报告期内，公司严格对标《公司法》《证券法》及财政部、证监会监管要求，将规范运作作为提质增效、回报投资者的核心根基，全面启动内部控制质量提升专项行动，构建董事会统筹决策、经理层组织实施、六大业务条线专项推进、审计与纪检全程监督的三级工作体系，压实全链条合规责任。

上半年已完成专项工作部署启动与分层分类内控宣贯培训，围绕财务资金、市场销售、采购管理、生产运营、研发项目、行政人事六大核心领域全面梳理业务流程、标注关键控制点，聚焦财务报告、资金管理、关联交易、募集资金、销售回款等高风险领域开展风险隐患排查，按照标准识别出需要专项提升的事项，实行闭环管理，推动合规理念贯穿经营全流程，公司治理规范化、精细化水平持续提升，为全年内控评价达标、防范重大合规风险、夯实高质量发展根基、切实维护投资者合法权益提供了坚实保障。

公司持续规范股东会、董事会运作机制，会议召集、召开、表决程序严格遵循法律法规及《公司章程》规定，全流程合法合规；建立会议决议跟办监督台账，对股东会、董事会各项生效决议实行闭环跟踪督办，确保决策部署刚性落地。

持续强化董事会专门委员会建设，健全独立董事全链条履职保障体系，全面保障独立董事知情权、参与权、监督权与独立意见发表权，充分发挥独立董事在重大经营决策事前把关、专业咨询、制衡监督等方面的核心作用；2026 年上半年，独立董事累计开展专项调研 5 次，切实提升履职效能，压实治理主体责任。

（二）强化风险管控

报告期内，公司始终坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维、红线意识，将风险防控治理深度融入企业经营、科研生产、合规管理全流程，持续健全“七位一体”风险防控管理机制，通过完善治理架构、健全制度体系、细化业务内控流程、强化动态处置，有效防范化解各类经营、安全、合规、财务、项目等风险。报告期内，强化全员法律合规意识培育、健全风险分级管控流程、提升精准防控能力等系列举措，有效化解各类风险隐患，确保风险始终处于可控、在控状态。

四、强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司高度重视投资者关系管理工作，持续加强与投资者的交流与沟通，倾听投资者的意见和建议，努力为投资者提供全方位、高质量的服务，增进投资者对公司的信任与支持。

2026 年上半年，公司在上证路演中心以网络互动的方式共召开 1 场业绩说明会、在全景路演平台召开 1 场贵州证监局组织的贵州省上市公司集体投资者交流活

动；借助线下专项调研等方式，接待投资者调研，接待包括个人投资者、证券投资基金公司、保险基金公司等机构投资者调研，通过上证 E 互动等平台完成 42 道互动问答，回复率 100%。

五、注重投资者回报机制，共享公司发展红利

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。其中 2025 年度现金分红已经实施完毕，合计向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），派发现金红利 34,000,000.00 元（含税）。

公司将根据自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动。

六、压实关键少数责任，健全利益共担机制

2026 年上半年，公司依据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，制定并审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。通过该项制度建立健全契合现代企业制度的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性与创造性，有效落实监督与经营管理职责，不断提升公司经营管理质量。

积极组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所、自律协会组织的专项培训，确保及时了解最新法律法规，提升履职能力，2026 年上半年，共计组织董事、高管参与培训 4 次，覆盖 7 人次。同时，公司持续加强与董事、高管的互动沟通，定期向其反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日